

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

鸿日达科技股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2026-02

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 | 中信建投、中信证券、浙商证券、天风证券、华金证券、第一创业证券、人保养老、远信投资、富国基金、天弘基金等 |
| 时间 | 2026年7月9日星期四 |
| 地点 | 东台润田精密科技有限公司（全资子公司）报告厅 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：周毅先生 半导体材料事业部负责人：万敏阳先生 证券事务代表：刘禹楠女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问题 1：请问公司半导体封装散热片材料项目目前进展情况如何？ 答：公司半导体封装散热片相关技术已成熟，已具备量产能力，且在进一步的积极扩产过程中。公司目前已获得多家国内外头部客户的供应商代码（Vendor Code）与部分订单，正与客户不断沟通协调，推进产能匹配与爬坡。公司近期已根据订单展开生产与批量供货，预计随着订单和产能的逐步增加，相关收入将从今年三季度开始稳步增长，具体经营情况，公司 |

将在定期报告或相关公告中按规定进行披露。

问题 2：请问目前公司半导体封装散热片材料项目的产能情况如何，能否介绍下公司半导体金属散热片材料业务未来的扩产计划？

答：目前公司半导体金属散热片项目已有 4 条产线投产，另有 2 条新增改进型产线接近投产，根据产品结构的差异，预计可支持 8-10 亿元的产值。公司计划在 2026 年年底继续扩产至 10-12 条产线，实现募投规划产能的落地。由于核心产线为公司自建，扩产周期相对较短且可控，公司有能力根据订单情况动态调整扩产节奏，并在工艺与研发端同步持续优化迭代。公司中远期的扩产目标是 30-50 条产线，公司正就此与多家重要客户沟通对表中，将按市场需求合理制订扩产计划与资金计划，若构成重大投资，将履行相关审核程序并以公告形式对外披露。

问题 3：请问公司半导体封装散热片在国内的行业格局是什么状态？公司和竞争对手相比，有什么优势？在全球范围内有哪些对标公司？目前公司半导体金属散热片的市场容量如何？

答：国内目前半导体封装散热片的主要供应商为台系企业健策精密，公司的产能扩张与订单的逐步落地，将形成有效的国产替代（此处“国产”指台湾除外的中国大陆境内产能，下同）；国内上市公司中目前仅我司形成成熟产能并开始批量交付。

公司在半导体封装散热片业务上深耕多年，已形成一定的技术优势与护城河，核心在于公司完全自建的模具生产能力与全自动电镀线生产能力，以

及在此开发过程中形成的核心技术与人才资源积累。在产品指标与生产良率上，公司已获重要客户一致认可，完全媲美台系竞争对手；且由于自建产线，公司在快速扩建先进产能的能力上具有一定优势，并已为产能扩建储备了大量的环保处理能力与电镀许可证。

2025 年国内半导体封装散热片市场规模约 40-50 亿元，行业年增速 20% 以上；目前国产化率较低，国产替代空间巨大，且随着 AI 算力、先进封装的快速增长，行业需求处在持续扩张趋势中。

问题 4：请问目前半导体封装散热片的行业壁垒有哪些？

答：行业主要存在如下壁垒：第一是精密工艺与技术壁垒，先进封装散热片对产品微结构、热膨胀系数（CTE）、批量良率等要求极高，整套产线工艺需要根据客户要求不断开发迭代；第二是下游超长周期的客户认证壁垒，头部封测客户完整认证周期 1-2 年，客户长期绑定，切换供应商意愿低；第三是较重的资产投入，包括产线设备与环保设施。

问题 5：我们关注到公司最近转让了有源光器件相关业务，请问与公司募投项目中光通信设备项目是否有关系？目前光通信设备项目的业务现状如何？

答：本次转让的有源光器件业务和募投光通信设备项目没有直接关联，二者业务主体完全分开，产品类型完全不同。转让标的鸿光通信主营有源光器件，仍处在技术开发阶段，目前无实际业务成果且未涉及募投资金；募投项目光通信设备项目由鸿日达科技股份有限公司运营，专注 FA 光纤阵

列等无源光精密零部件，资金为专项募集资金、专款专用。本次剥离有源业务系根据经营发展战略需求，有利于公司调整产业和产品结构，促进经营资金回流，推动业绩稳步改善与长期价值增长。

目前光通信募投项目相关自动化产线设计与开发已完成，经营模式为自建产线，生产销售相关无源光器件产品。相对于无源光器件的传统人工生产模式，该自动化产线在产品生产过程中能有效提高生产效率。公司在试生产过程中已实现部分客户导入，当前处于客户拓展与产能扩展同步进行阶段。近期，随着公司加大产能建设，客户需求也在快速增长，相关业务有望在今明两年逐步实现突破，具体经营情况公司将在定期报告或相关公告中按规定进行披露。该项目仍处于募集资金持续投资过程中，后续若有新增投资构成重大投资的，公司将履行相关审核程序并以公告形式对外披露。

问题 6：请问公司目前传统的连接器业务情况如何？

答：消费电子连接器是公司营收的核心基本盘，主营卡座、Type-C、BTB等精密连接件，长期稳定配套华勤、闻泰、小米、传音等客户，2025 年营收保持增长，持续为新业务提供现金流支持。

受原材料涨价与行业激烈竞争影响，公司连接器业务整体利润阶段性承压。作为应对，公司一方面对产线进行升级优化、改善产品结构提升毛利，积极拓展汽车、新能源等连接器业务对冲消费电子周期；另一方面公司也在缩减长期非盈利产品的生产销售，剥离无实际产出的非主业项目和低毛

| | |
|------|---|
| | <p>利项目，以盘活资产收回资金，聚焦到半导体散热、无源光通信、3D 打印等高成长赛道，推动公司尽快达到业绩拐点，进入发展快车道。</p> <p>问题 7：请问公司 2026 年下半年是否有再融资计划？</p> <p>答：公司目前已获得小额快速定增的股东会授权，具体融资计划将视公司半导体封装散热片、3D 打印、光通信器件等新业务拓展的节奏与资金需求而定。在形成明确融资计划后，公司将履行相关审核程序并及时公告披露。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2026 年 7 月 9 日 |